

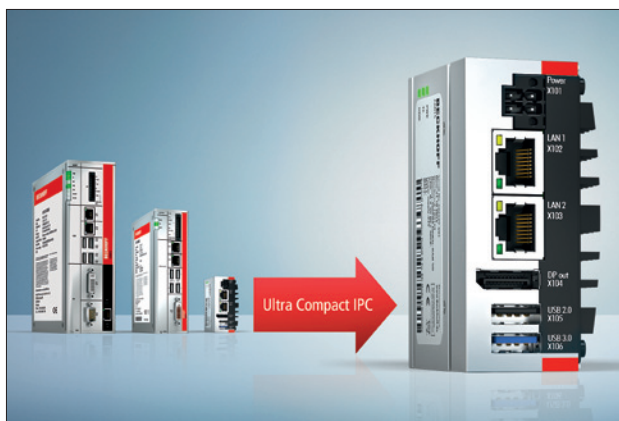
# Beckhoff Roadshow opět představí novinky i ukázky realizovaných projektů

Další ročník semináře Beckhoff Roadshow 2017 se postupně uskuteční v Trenčíně (24. 10.), Praze (25. 10.), Českých Budějovicích (1. 11.) a v Brně (2. 11.). Pořadatelé ze společnosti Beckhoff připravili výběr z nových produktů a ve spolupráci se svými zákazníky také několik ukázek realizovaných projektů.

Mezi novinkami budou např. ultrakompaktní průmyslové počítače C6015 (obr. 1) s neuvěřitelně malými rozměry a velmi příznivým poměrem výkonu a ceny. Jde o IPC určená k montáži do rozváděče, která vyhovují průmyslovým standardům, včetně rozšířeného rozsahu pracovních teplot (do +55 °C) a velké odolnosti proti vibracím. Standardem je rozhraní pro EtherCAT. Počítače jsou vybaveny procesory Intel Atom s až čtyřmi jádry. Jde výhradně o procesory řady Embedded Line, u nichž výrobce zaručuje dlouhodobou dostupnost na trhu. Rozměry IPC jsou 82 × 82 × 40 mm. I přes malé rozměry jsou nová IPC vhodná i pro náročné úlohy řízení, vizualizace a komunikace.

Další novinkou jsou měřicí moduly pro EtherCAT (obr. 2). Tyto moduly je možné přímo kombinovat s libovolným terminálem komunikačního systému EtherCAT z jejich široké nabídky. Přinášejí velkou rychlost měření, v základním provedení až 50 000 vzorků za sekundu s 24bitovým rozlišením, dále velmi přesnou synchronizaci, do 1 μs (díky distribuovaným hodinám reálného času v komunikačním systému EtherCAT), přesnost měření až 100 ppm s velkou teplotní stabilitou (v konkrétním případě přesnost závisí na rozsahu měření) a proak-

tivní diagnostiku, zaručující velkou spolehlivost. K dispozici jsou moduly s multifunkčním vstupem, k měření napětí, k měření proudu, s měřicím můstkem a pro piezoelektrické senzory IEPE.



Obr. 1. Ultrakompaktní IPC řady C6015 jsou ve srovnání s předchozí verzí IPC až o třetinu menší



Obr. 2. Přesný a rychlý měřicí modul pro terminál EtherCAT

Pro vestavná PC řad CX9020, CX5120, CX5130 a CX5140 je nyní k dispozici volitelná modifikace CX2900-0107, s níž tyto produkty splňují požadavky směrnice ATEX II 3G Ex nA II T4 Gc pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par (zóna 2) a ATEX II 3D Ex tc IIIC T1 35 °C Dc pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu (zóna 22). Konstruktorům strojů a zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou určeny také nové multidotykové ovládací panely CPX, rovněž vhodné do zón 2 a 22.

Produktoví specialisté firmy Beckhoff účastníkům dále představí celý sortiment



Obr. 3. Pro konstruktéry strojů a zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou k dispozici dotykové panely s certifikátem ATEX vhodné do zón 2 a 22 s nebezpečím výbuchu

techniky Beckhoff pro řízení polohy a pohybu, od jednoduchých manipulátorů až po řídicí systémy CNC strojů nebo transportních systémů s autonomními vozíky XTS. Chybět nebude ani téma bezpečnosti strojů a strojních zařízení.

Více informací zájemci najdou na adrese [www.beckhoff.com/cz/roadshow](http://www.beckhoff.com/cz/roadshow). Účast je bezplatná, podmíněná předchozí registrací.

(Bk; Foto: Beckhoff)

## ► Program konference Technical Computing Prague 2017

Společnost Humusoft s. r. o. zve k účasti na 24. konferenci v její zavedené řadě mezinárodních konferencí, která se pod názvem *Technical Computing Prague 2017* (TCP 2017) uskuteční v Kongresovém centru

ČVUT, Thákurova 1, Praha 6, ve středu 8. listopadu 2017. Náplní konference TCP 2017 budou především přednášky a prezentace uživatelů systémů Matlab & Simulink a dSpace, informující o použití těchto osvědčených a výkonných nástrojů při řešení výpočetních a simulačních úloh v nejrůznějších oborech průmyslu, vědy, výzkumu a výuky. Součástí konference bude přednáška společnosti Humusoft zaměřená na novinky a trendy vývoje

programových systémů Matlab a Simulink doplněná prezentací firmy dSpace.

Další informace o konferenci TCP 2017, včetně časového rozvrhu přednášek, obsahu sborníku, přihlášky k účasti atd., lze nalézt na [www.humusoft.cz](http://www.humusoft.cz) v oddílu *Akce a události*. Tamtéž jsou pod záložkou *Archiv* dostupné v elektronické podobě sborníky z předchozích ročníků řady konferencí *Technical Computing*. (sk)